

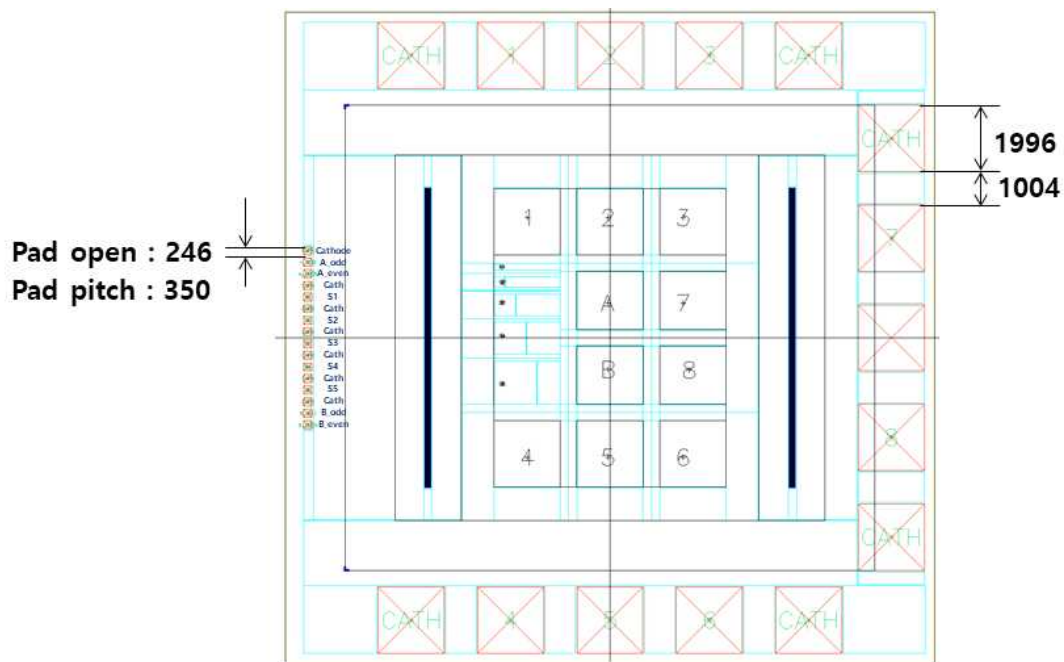
상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	TEG Wafer (RDP370FACZ)	매	9	-

상 세 내 역

1. 주요규격

① TEG Wafer (RDP370FACZ)



< TEG wafer Lay-out 예시 이미지 >

- wafer size : 8 inches
- Substrate size (mm) : 19.6 x 19.6
- Encap glass size (mm) : 13.8 x 15.8 x 0.7t (10 x 12 x 0.3t)
- Die size : 19,600 x 19,600, Scribe Lane : 400 um

2. 기타사항

- 납품위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 XR 디바이스 개발 지원센터 202호
- 납품개요 : 규격서의 조건에 맞는 물품을 납품
- 납품기한 : 계약일로부터 14일 이내
- 규격문의 : 실감미디어연구센터 김재윤 선임연구원(054-460-9057)